

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于签订项目投资协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司中长期发展战略的需要，加快产能提升和技术创新，实现公司在智能电网、新能源汽车及军工装备三大战略领域的长远发展，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与西安高新技术产业开发区（以下简称“西安高新区”）管理委员会签署《石家庄通合电子科技股份有限公司西北总部建设项目协议书》（以下简称“投资协议”）。投资协议约定，公司拟在西安高新区内投资建设公司西北总部建设项目（包括但不限于拟实施的基于电源模块国产化的多功能电源设备投资项目、基于电源模块国产化的多功能电源生产基地项目、通合西安研发中心项目），总投资额不低于45,000万元，其中固定资产投资额不低于30,000万元，单位用地面积投资强度不低于1,000万元/亩。

具体内容详见2021年3月6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2021-012）。

二、对外投资进展情况

公司与西安高新区管理委员会于2021年3月22日签署了《石家庄通合电子科技股份有限公司西北总部建设项目协议书》，主要内容如下：

1、协议主体

甲方：西安高新技术产业开发区管理委员会

乙方：石家庄通合电子科技股份有限公司

2、项目主要内容

公司西北总部建设项目包括但不限于乙方拟实施的基于电源模块国产化的多功能电源设备投资项目、基于电源模块国产化的多功能电源生产基地项目、通合西安研发中心项目。

3、项目规模

项目总投资额不低于45,000万元，其中固定资产投资额不低于30,000万元，单位用地面积投资强度不低于1,000万元/亩。

4、协议生效时间

本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

三、已履行的审批程序

公司于2021年3月5日召开第三届董事会第十八次会议、2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订项目投资协议的议案》。

四、备查文件

《石家庄通合电子科技股份有限公司西北总部建设项目协议书》

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年三月二十三日